

SMF Leiterplattenkontakte

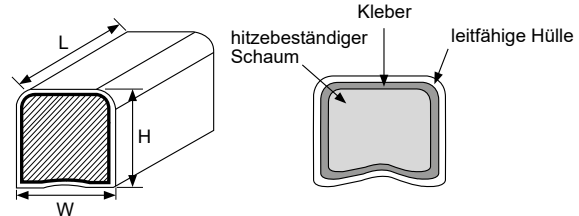


Merkmale

- für SMT-Bestückung
- geringer Oberflächenwiderstand
- hervorragende Elastizität ohne Verbiegen oder Brechen
- reflow-lötbar, halogenfrei
- glatte Oberfläche ermöglicht Pick & Place für Massenfertigung
- Material Hülle: leitfähige PI-Folie (Oberfläche: Ni-Cu-Sn), Kern: PU-Schaum, UL94V-0

Abmessungen

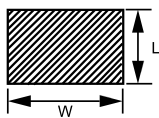
► Einheit = mm



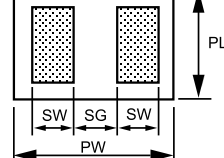
Art.-Nr.	Typ	W (mm)	H (mm)	L (mm)
611 09 03	SMF-3-3-2	3,0	3,0	2,0
611 09 05	SMF-3-3-5	3,0	3,0	5,0
611 09 06	SMF-5-10-5	5,0	10,0	5,0
611 09 01	SMF-6-6,5-4	6,0	6,5	4,0
611 09 02	SMF-6-6,5-9	6,0	6,5	9,0
611 09 04	SMF-10-6-4	10,0	6,0	4,0

! Spezifikationen		
Beschreibung	Wert	Testmethode
Wiedererhalt nach Stauchung	> 90 %	ESQ-517-26, ESQ-517-18
Haftung Hülle	Stufe 5	ESQ-517-16
Repulsionskraft	< 0,45 kgf	ESQ-517-27
Abschirmwirkung	-70 dB (Ø)	MIL DTL-83528C modified

SMF-Größe



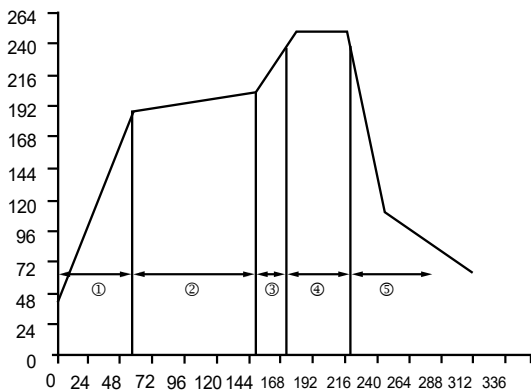
Lötadempfehlung



SMF Größe		PCB Platzbedarf		Lötpad		Lötpasten-Stärke
W	L	PW	PL	SW	SG	
4,0	3,0	4,5	3,5	1,5	1,5	0,15
5,0	3,0	5,5	3,5	2,0	1,5	0,15
5,0	4,0	5,5	4,5	2,0	1,5	0,15
8,0	8,0	8,5	8,5	3,0	2,5	0,15

Abmessungen: mm

- SMF Gasket Reflow-Lötbedingungen (Empfehlungen)



! Spezifikationen		
Beschreibung	Temperatur (Grad)	Zeit (Sek.)
①	RT~150	1~4 °C/s
②	150~170	60~120
③	min. 200	2~4 °C/s
④	230~260	max. 10
⑤	~RT	min. 60

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0